

investor

newsletter

IM FOKUS

- 2-3 ■ High Tech fürs mobile Wohnzimmer

TRENDS & THEMEN

- 4 ■ High-Speed-Internet, Telefonie und analoges Fernsehen in einer Leitung
■ Infineon und Bundesinnenministerium vereinbaren Sicherheitskooperation
■ Infineon entwickelt Chipnetzwerk für „intelligente“ Industrietextilien

ENTWICKLUNG & PRODUKTE

- 5 ■ Biochips: Der Entwicklungsstand bei Infineon im Überblick
– Im Markt: Innovatives System zur Medikamentenentwicklung
– In der Entwicklung: Das elektronische Labor
– Im Forschungsstadium: Chip für die Grundlagenforschung am Gehirn

ZAHLEN & FAKTEN

- 6-7 ■ Gute Umsätze in allen Geschäftsbereichen

AUSBLICK

- 8 ■ Ausblick bis zum Ende des Kalenderjahres 2003
■ Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des Geschäftsjahres 02/03



Mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Information und bessere Umweltverträglichkeit. Welcher Autofahrer wünscht sich das nicht? Halbleiter von Infineon leisten einen wichtigen Beitrag, um das Leben im mobilen Wohnzimmer angenehmer zu gestalten.

HIGH TECH FÜRS MOBILE WOHNZIMMER

Bei Automobil-Halbleitern ist Infineon europaweit die Nummer eins und liegt weltweit auf Rang zwei.

Moderne Autos sind nicht gerade bastlerfreundlich. Früher, da gab es oft schwarze Hände für jene, die selbst Hand an ihr Auto legten, ehe sie für teures Geld eine Werkstatt bemühten. Dem Schrauben sind heute enge Grenzen gesetzt – allenfalls Oldtimer-Liebhaber frönen noch der Mechaniker-Leidenschaft. Bei modernen Autos holt man sich schwarze Finger am ehesten noch beim Reifenwechsel.

Das Automobil denkt mit

Und das liegt auch an Infineon: Vieles am Auto wird inzwischen elektronisch gesteuert, von der Klimaanlage über die Sitzeinstellung und den Airbag bis hin zu Motor und Getriebe. In einer Limousine sind heute 20 bis 30 Kilometer Kabel verlegt, der Halbleiterwert im Auto liegt im Durchschnitt bei über 200 Euro, Tendenz steigend.

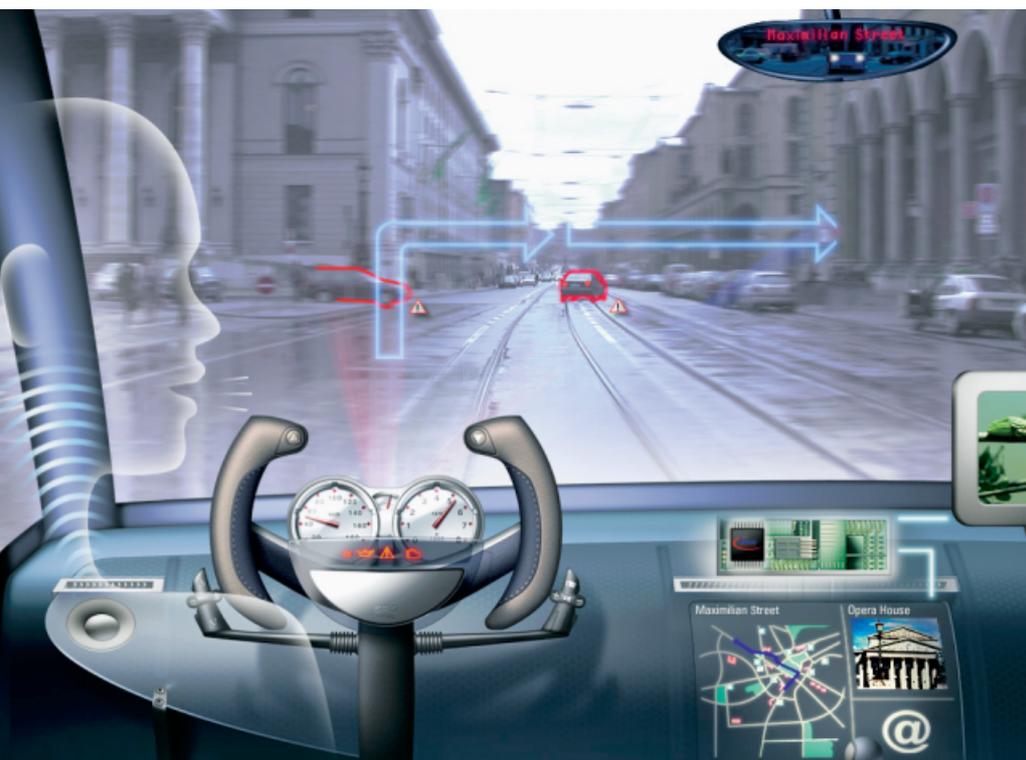
Und derzeit schicken sich elektronische Systeme an, auch noch in die letzten Bastionen von Mechanik und Hydraulik vorzudringen: Geforscht wird bei Infineon an Halbleiterlösungen für die elektronische Lenkung, die ohne Lenkgestänge auskommt. Die Lenkbefehle werden im Auto der Zukunft voraussichtlich elektronisch weitergeleitet werden, womit die Lenksäule wegfiele – und mit ihr ein sperriger Gefahrenpunkt. Ebenso in Aussicht ist die elektromechanische Bremse, die hydraulische Systeme ablösen könnte; kürzere Bremswege würden zudem die Sicherheit erhöhen.

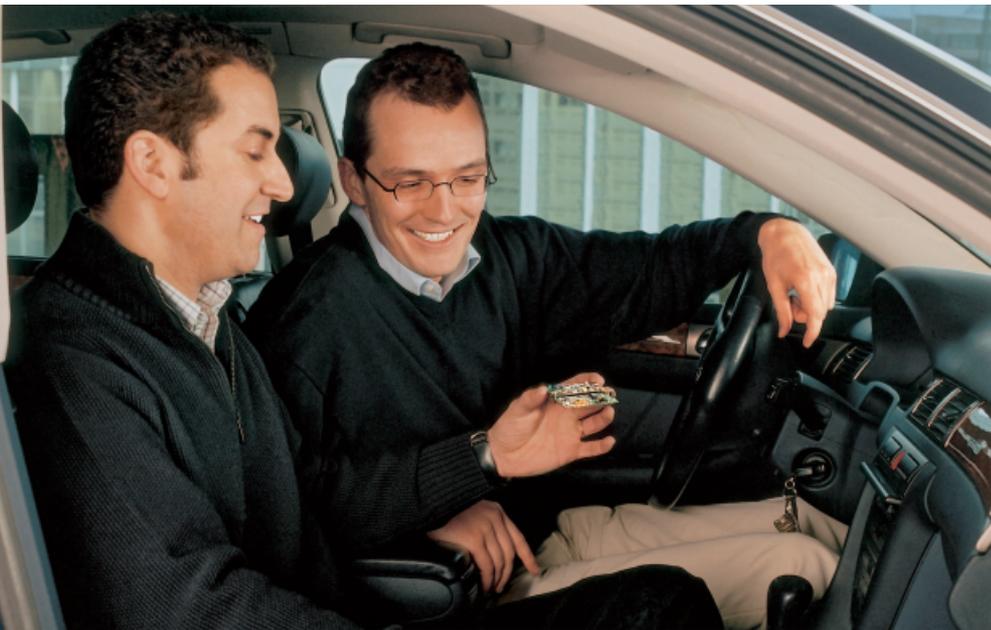
Für den Infotainment-Bereich liefert Infineon Chipsätze und Software für Navigationssysteme und Telematikdienste sowie mobile Internet-Zugänge.

Infineon bietet 80 % der Halbleitertypen im Auto an

Ein Zukunftsmarkt, und Infineon ist ganz vorne mit dabei. Seinen Kunden bietet das Unternehmen über 80 Prozent der Halbleitertypen an, die in Autos verwendet werden: Sensoren zur Datenerfassung, Mikrocontroller zur Datenverarbeitung und Leistungshalbleiter zur Ansteuerung. Im vergangenen Jahr belegte Infineon bei den Automobil-Halbleitern weltweit den zweiten Rang, in Europa ist Infineon die Nummer eins. Der Markt ist dabei der stabilste der Halbleiterbranche: Zum einen unterliegt die Automobilproduktion auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten nur relativ geringen Schwankungen, zum zweiten steigt die Elektronikausstattung pro Auto immer weiter an. Infineons Bereich für Automobil-Halbleiter wächst seit vielen Jahren schneller als der Markt und will dies auch zukünftig tun.

Infineon bietet der Automobilindustrie Halbleiter für vier große Anwendungsbereiche. Das Unternehmen ermöglicht mit seinen leistungsfähigen Halbleitern für Motor- und Antriebssteuerungen (Powertrain) eine optimierte Kraftstoffnutzung, um einerseits die Motorleistung zu steigern und andererseits den Schadstoffausstoß weiter zu reduzieren. Im Bereich Safety Management bietet Infineon Halbleiter z. B. für Servolenkung, ABS, automatische Stabilitätskontrolle (ESP) oder Airbags, um das Auto einfacher beherrschbar und damit sicherer zu machen. Und da ein entspannter Fahrer auch ein sicherer Fahrer ist, geht es im dritten Segment Comfort Management um Halbleiter unter anderem für Lichtmodule, elektronische Türschlösser, automatische Lüftungskontrolle und elektronische Sitzverstellung. Schließ-





lich liefert Infineon im Infotainment-Bereich Chipsätze und komplette Halbleiterlösungen für Kommunikations- und Navigationssysteme; zum Teil gemeinsam mit strategischen Partnern für Softwareentwicklung oder Modulfertigung.

Mit seinem seit 35 Jahren gewachsenen Systemverständnis, das über die elektronische Applikation hinausgeht, will das Unternehmen mehr und mehr Halbleiterlösungen anbieten, nicht nur einzelne Produkte oder Chipsets. Und das ist ganz im Sinne des Unternehmensprogramms Agenda 5-to-1.

Die Sensortechnik wird im Auto immer wichtiger

Der Sensortechnik im Automobil kommt eine stark zunehmende Bedeutung zu: Dem Markt für Automobil-Halbleitersensoren wird ein jährliches Wachstum von bis zu 20 Prozent vorausgesagt. Immer wichtiger werden Sensoren beispielsweise für die Reifendruckkontrolle. So greifen in den USA von diesem Jahr an neue gesetzliche Bestimmungen, wonach der Reifendruck kontinuierlich überwacht werden muss. Bereits im Jahr 2004 sollen 35 Prozent der zugelassenen Neufahrzeuge über

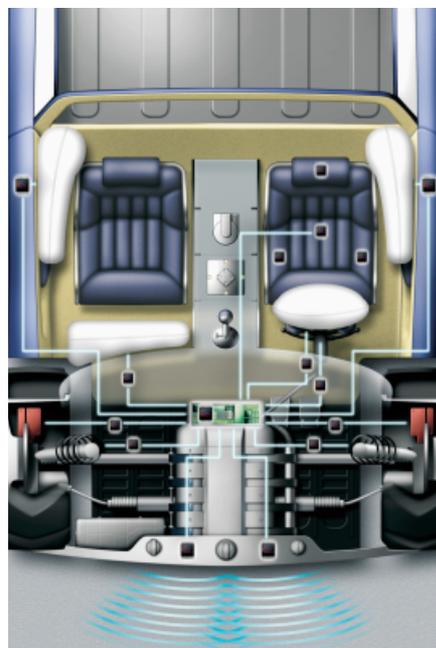
die entsprechenden Sensor-Kontrollsysteme verfügen; im Jahr 2005 soll der Anteil dann auf 65 Prozent steigen.

Und auch Infineon rüstet sich für den Wachstumsmarkt Sensorik. Das Unternehmen hat den Sensorbereich im vergangenen Geschäftsjahr neu strukturiert und in seine Automobil-Halbleitersparte integriert. Zum Portfolio gehören dabei Magnetfeld-, Druck- und Temperatursensoren. Dabei ist Verstärkung in Sicht: Mit der Übernahme von SensoNor, einem führenden Anbieter von Reifendruck- und Beschleunigungssensoren aus Norwegen,

wird Infineon sein Geschäft mit Drucksensoren deutlich ausbauen und Beschleunigungssensoren neu ins Portfolio aufnehmen. Infineons Marktanteil bei den Automobil-Halbleitersensoren verdoppelt sich damit auf rund 15 Prozent.

Und wenn es um den Lebensstil jedes Einzelnen geht, zu dem Infineon mit seinen intelligenten Halbleiterlösungen beitragen will, dann geht es gerade auch um das Auto: Immer stärker wird es als mobiles Wohnzimmer empfunden, als Ausdruck des individuellen Lebensstils. Und das heißt für Infineon, das Auto „intelligent“ zu machen, es gewissermaßen mit Hirn und Nerven auszustatten, so dass es sich fast schon nach Tageslaune verändern lässt. Was auch immer die Zukunft des Autos bringt – Infineon ist dafür gerüstet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.infineon.com/news



Seitenairbags schützen den Autoinsassen im Kopfbereich. Auch hier sorgen Bauelemente von Infineon für einen reibungslosen Ablauf.



Vielseitige Faser: Mit dem optischen Modul „Triport-BIDI“ von Infineon werden analoge Fernsehsignale und digitale Kommunikationsdaten auf einer einzigen Glasfaser verbunden.

HIGH-SPEED-INTERNET, TELEFONIE UND ANALOGES FERNSEHEN IN EINER LEITUNG

Drei in einem – auf diese griffige Formel lassen sich die technischen Parameter des neuen optischen Triplexer-Moduls von Infineon bringen. Das „Triport-BIDI“ mit einer Reichweite von bis zu 20 Kilometern ermöglicht die Kommunikation über eine einzige optische Glasfaser-Verbindung in beide Richtungen und ist im Unterschied zu herkömmlichen bi-direktionalen Modulen mit einer zusätzlichen Photo-Diode als Empfänger für analoge Videosignale ausgestattet. Auf diese Weise können erstmals drei Anwendungen – analoges Fernsehen, Telefonie und Hochgeschwindigkeits-Internet – über ein und dieselbe Leitung übertragen werden. Bislang werden Haushalte in der Regel über zwei getrennte Netze mit diesen Diensten versorgt. Daneben bietet das so genannte Single-Fiber-Konzept weitere Vorteile: Die Kapazität der vorhandenen Netzwerke wird erhöht, die Kosten für die Kabelverlegung sowie für Wartung und Betrieb des Netzwerkes können reduziert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.infineon.com/news

INFINEON UND BUNDESINNENMINISTERIUM VEREINBAREN SICHERHEITSKOOPERATION

Das Bundesministerium des Inneren und Infineon wollen in Zukunft eng im Bereich der IT-Sicherheit zusammenarbeiten. Ziel der unlängst von Bundesinnenminister Otto Schily und Infineons Vorstandsvorsitzendem Dr. Ulrich Schumacher vereinbarten Kooperation ist es, die Grundlagen für eine verbesserte Sicherheit von IT-Systemen für die öffentliche Verwaltung, aber auch für Unternehmen und Privathaushalte zu schaffen. In mehreren Bereichen wollen beide Partner geeignete Konzepte und Sicherheitsstandards entwickeln – angefangen bei der Chipkartentechnologie über den zuverlässigen Schutz von Computersystemen und -netzwerken bis hin zum manipulationsfreien Einsatz von mobilen Endgeräten zu Signaturzwecken und im Zahlungsverkehr. Eines der Projekte zielt etwa auf die Entwicklung einer sogenannten qualifizierten Signaturkarte, die gleichzeitig als Bürger-, Job- und Gesundheitskarte fungiert und dabei auch die Aufnahme biometrischer Daten ermöglichen soll. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.infineon.com/news



Bundesinnenminister zu Besuch: Otto Schily und Infineon-CEO Ulrich Schumacher unterzeichneten den Vorvertrag für eine weitreichende Sicherheitskooperation.



Forscher der Infineon Technologies AG haben einen Weg gefunden, großflächige Textilien wie Teppichböden oder Zeltdächer mit „Intelligenz“ auszustatten.

INFINEON ENTWICKELT CHIPNETZWERK FÜR „INTELLIGENTE“ INDUSTRIETEXTILIEN

Forscher von Infineon haben einen Weg gefunden, großflächige Textilien wie Teppichböden oder Zeltdächer mit „Intelligenz“ auszustatten. In die Textilstruktur eingewoben, wacht ein sich selbst organisierendes Netzwerk aus wasser- und hitzebeständigen Chips bei Bedarf über Temperatur, Druck oder Vibrationen. Ein mit dieser Elektronik-Architektur ausgestatteter Teppichboden könnte etwa als Bewegungs- oder Feuermelder dienen beziehungsweise Alarm- und Klimaanlage steuern. Die Integration von LEDs eröffnet derartigen Industrietextilien weitere Einsatzfelder, etwa als Leitsysteme zur Steuerung von Besucherströmen, zur flexiblen Kennzeichnung von Fluchtwegen oder als Werbeträger. Besonderer Vorteil des Chipnetzwerks ist seine stabile Funktionsfähigkeit und große Fehlertoleranz: Fällt ein Chip aus, erkennt es diese Schwachstelle von selbst, organisiert sich blitzschnell neu und hält somit den Informationsfluss aufrecht. In Kooperation mit Partnern aus der Textilindustrie soll das vorliegende Konzept in zwei Jahren zu einem funktionsfähigen und großflächigen „intelligenten“ Gewebe weiterentwickelt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter www.infineon.com/news

BIOCHIPS: DER ENTWICKLUNGSSTAND BEI INFINEON IM ÜBERBLICK

IM MARKT: INNOVATIVES SYSTEM ZUR MEDIKAMENTENENTWICKLUNG

Bereits auf dem Markt ist der so genannte Flow-Thru-Chip, der in der Pharmaindustrie dazu dient, neue Medikamente zu entwickeln. Er hilft bei der Suche nach Wirkstoffen gegen Entzündungen, Brust- und Lungenkrebs, darüber hinaus Degenerationserscheinungen des Nervensystems, beispielsweise Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose. Der Chip, den Infineon gemeinsam mit der amerikanischen Biotech-Firma MetriGenix entwickelt hat, kann auf einem Quadratzentimeter Grundfläche bis zu 400 Gene zugleich testen und kam Ende März auf den Markt. Was den Flow-Thru-Chip gegenüber anderen Systemen auszeichnet, ist seine dreidimensionale Struktur: Die Probe wird mehrmals durch hunderttausende parallele Mikrokanäle gepumpt, die den Chip von der Ober- bis zur Unterseite durchziehen. Dieses automatisierte Verfahren verkürzt die Testzeit, es ist gegenüber planaren Methoden empfindlicher, genauer, spart Probenmaterial und teure Reagenzien.

MetriGenix bestückt die Chips mit künstlich hergestellten Genabschnitten, die in ihrer Aktivität jeweils krankheitstypisch verändert sind. Der Flow-Thru-Biochip gehört zu den Genexpressionschips: Indem ein Enzym zugegeben wird, wird untersucht, ob ein potenzieller Wirkstoff die Genaktivität günstig beeinflussen kann. Bei der folgenden Reaktion wird Licht ausgesendet, das mit einer hochempfindlichen CCD-Kamera (Charge Coupled Device) analysiert wird. Der Aufwand für den Kunden ist gering, da der Chipinhalt je nach Kundenwunsch vordefiniert ist.

Rund 60.000 Euro kostet die komplette Systemlösung „4D Array System“. Und während es in der Pharmaindustrie heute zwölf bis 15 Jahre dauert, bis ein neues Medikament entwickelt ist, verkürzt der Biochip die Zeit um ein bis zwei Jahre, während sich mit einem erfolgreichen Massenmedikament bis zu 500 Millionen Euro im Jahr umsetzen lassen.

IM FORSCHUNGSSTADIUM: CHIP FÜR DIE GRUNDLAGENFORSCHUNG AM GEHIRN

Im Forschungsstadium befindet sich ein Biochip, der Wissenschaftlern ein lang gesuchtes Instrument zur Grundlagenforschung an die Hand geben könnte: Der Neurochip lässt auf neue Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns hoffen. Dabei werden einzelne Nervenzellen isoliert und auf einen Chip aufgebracht, wo sie zu einem neuronalen Netz zusammenwachsen. Es entsteht ein hybrides System aus einem Halbleiter-Chip und Neuronen, das über mehrere Wochen am Leben erhalten werden kann. Den Infineon-Forschern ist das im Experiment bereits gelungen, gemeinsam mit Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried (bei München), die das zellbiologische Know-how als eine der weltweit führenden Gruppen einbringen: Die schwachen elektrischen Signale der Nervenzellen einer Schnecke – maximal fünf Millivolt – werden mit Hilfe eines Chips verstärkt, der auf einer Fläche von einem Quadratmillimeter über 16.384 hoch empfindliche Sensoren verfügt. Die Signale gehen dann zur Auswertung an ein Computersystem.

Das System verspricht, in Zukunft Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen im Gehirn untersuchen zu können – mit ungeahnten Möglichkeiten für Anwendungen in Biomedizin, Biotechnologie und Hirnforschung. Die Funktionsweise und das Zusammenwirken der Nervenzellen zu verstehen, könnte ein erster Schritt sein, heute unheilbare Krankheiten des Gehirns zu enträtseln. Weitere Anwendungen versprechen sich die Forscher im Bereich der zellgestützten Medikamentenentwicklung.

IN DER ENTWICKLUNG: DAS ELEKTRONISCHE LABOR

In Entwicklung befindet sich bei Infineon derzeit ein vollelektronischer Biochip, der völlig ohne optische Auswertegeräte auskommt. Dabei benutzt Infineon als weltweit erstes Halbleiterunternehmen Standard-Chiptechnik: Normale CMOS-Halbleiter-Chips, ähnlich denen in Mobiltelefonen, werden durch prozesstechnische Erweiterungen zu Biochips abgewandelt. Der vollelektronische Biochip ist für die Detektion von DNA gedacht. Dabei werden 128 Sensorpositionen mit so genannten Fänger-molekülen bestückt, die ein exaktes Gegenstück für diejenigen DNA-Sequenzen darstellen, auf deren Vorhandensein eine Probe untersucht werden soll. Dazu spalten beigeseetzte Enzyme eine weitere Substanz, die ebenfalls beigemischt wird, in elektrisch aktive Bestandteile auf. In der Folge entstehen an den Goldelektroden minimale Ströme, aus deren zeitlichem Verlauf bestimmt werden kann, wie sich die Probe zusammensetzt.

Den Infineon-Forschern ist es dabei gelungen, den Herstellungsprozess der Goldelektroden so zu konzipieren, dass sie die sensiblen Schaltkreise nicht beeinträchtigen. Sollten die Praxistests erfolgreich verlaufen, wären die Chips äußerst vielseitig einsetzbar. Sie können Infektionskrankheiten identifizieren und herausfinden, ob ein Patient ein Medikament verträgt oder nicht. Einsetzbar ist der Chip zudem in der Krebsfrüherkennung: er hilft, Immunreaktionen zu testen und latenten Erbkrankheiten auf die Spur zu kommen. In der Gerichtsmedizin lassen sich Straftäter mit Hilfe von Gen-Datenbanken dingfest machen. Besonders dürften jedoch Krankenhäuser davon profitieren: Günstiger, besser und schneller schafft der Biochip die Laborarbeit.

GUTE UMSÄTZE IN ALLEN GESCHÄFTSBEREICHEN

ZAHLEN FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2003: MARKTUMFELD BESSER, WECHSELKURS UNGÜNSTIG

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres hat sich das Marktumfeld im Speicherbereich verbessert. Allerdings war das Euro/Dollar-Wechselkursverhältnis ungünstig sowie der Preisdruck weiterhin stark. Infineon liegt beim Umsatz mit 1,47 Milliarden Euro fast auf dem Niveau des Vorquartals; gegenüber dem Vorjahresquartal wurden 11 Prozent mehr umgesetzt. Der Quartals-Nettoverlust hat sich, gegenüber dem Nettoverlust von 328 Millionen Euro im Vorquartal, deutlich auf 116 Millionen Euro verbessert. Dies vor allem, da die Produktivität gesteigert, die Kosten weiter gesenkt und im Gegensatz zum Vorquartal keine nennenswerten Effekte aus Wertberichtigungen auf Lagerbestände wirksam wurden. Enthalten darin sind Wertminderungen, unter anderem 68 Millionen Euro durch die teilweise Goodwill-Abschreibung der Beteiligung an Catamaran Communications.

Infineon nutzte die niedrigen Zinssätze am europäischen Anleihemarkt, um seine Cash-Position zu verbessern und gab am 5. Juni eine nachrangige Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 2010 aus; dies entsprach einem Bruttoerlös von 700 Millionen Euro. Die Anleihe kann in bis zu 68 Millionen Infineon-Stammaktien gewandelt werden. Die Brutto-Cash-Position lag damit bei 2,4 Milliarden Euro, gegenüber 1,5 Milliarden Euro im vorausgegangenen Quartal. Daneben hat Infineon entschieden, die Anteile an ProMOS Technologies zu veräußern; seit 1. April wird die ProMOS-Beteiligung somit nicht mehr nach der Equity-Methode bilanziert, sondern wie Wertpapiere des Umlaufvermögens behandelt.

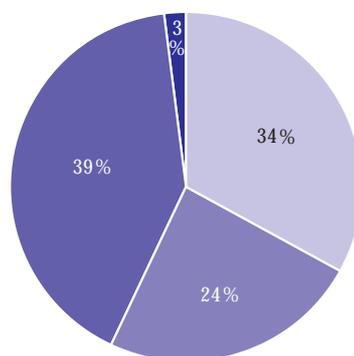
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2003 hat Infineon mit 4,4 Milliarden Euro 22 Prozent mehr umgesetzt als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust betrug 484 Millionen Euro, gegenüber 515 Millionen Euro im Vorjahr. Die Steueraufwendungen für die ersten neun Monate dieses Geschäftsjahres liegen bei 98 Millionen Euro, verglichen

mit Steuererträgen in Höhe von 345 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBIT hat sich erheblich auf minus 369 Millionen Euro verbessert, gegenüber minus 845 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Im Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik ist der Umsatz im ver-

gangenen Quartal um ein Prozent auf 351 Millionen Euro zurückgegangen, vor allem durch eine nichtlineare Buchung von Lizenzeinnahmen. Das EBIT lag mit 49 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorquartals, vor allem, da das hohe Rentabilitätsniveau durch volle Kapazitätsauslastung, sowie durch gesteigerte Produktivität mit der fortgesetzten Produktions-

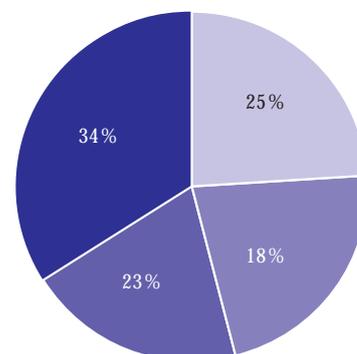
Segment-Umsatzerlöse in Mio. Euro für das Quartal zum 30.06.03



- Kommunikation: 506 Mio. Euro
- Automobil- und Industrieelektronik: 351 Mio. Euro
- Speicherprodukte: 569 Mio. Euro
- Sonstige und Konzernfunktionen: 45 Mio. Euro

Infineon: 1.471 Mio. Euro

Regionale Umsatzverteilung in Prozent für das Quartal zum 30.06.03



- Deutschland
- Restliches Europa
- Amerika (NAFTA)
- Asien/Pazifik

AUSGEWÄHLTE DATEN DER

QUARTALS-KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG

3 MONATE ZUM

31.03.03 30.06.03

	in Mio. Euro	
	31.03.03	30.06.03
Umsatzerlöse	1.484	1.471
Bruttoergebnis vom Umsatz	201	387
Forschungs- und Entwicklungskosten	- 254	-273
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	- 164	-158
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	- 10	-5
Betriebsergebnis	- 227	-110
Zinsergebnis	-11	-10
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	2	-1
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-232	-126
Erträge (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-96	10
Konzernfehlbetrag	-328	-116
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien – Basis und verwässert	721	721
Konzernfehlbetrag je Aktie – Basis und verwässert	-0,45	-0,16
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-223	-115

AUSGEWÄHLTE KONZERN-BILANZDATEN	ZUM	
	30.09.02	30.06.03
Aktiva	in Mio. Euro	
Zahlungsmittel	1.199	827
Wertpapiere des Umlaufvermögens	738	1.545
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	758	723
Vorräte	891	999
Umlaufvermögen	4.191	4.762
Sachanlagen	4.491	3.975
Bilanzsumme	10.918	10.572
Passiva		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120	96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197	793
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	2.383	1.911
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.710	2.367
Summe Verbindlichkeiten	4.760	4.954
Eigenkapital	6.158	5.618

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG	3 MONATE ZUM	
	31.03.03	30.06.03
	in Mio. Euro	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	101	183
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-323	-604
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	4	615
Abschreibungen	359	361
Mittelabfluss für Sachanlagen	230	138

umstellung auf 200-mm-Wafer gehalten werden konnte. Dabei hat sich Infineon mit seiner TriCore™-Mikrocontroller-Technologie beim Motormanagement eine führende Position in Europa erarbeitet. Die Marktanteile für Netzteil- und Stromversorgungs-Applikationen (CoolMOS™- und OptiMOS™-Technologie), vornehmlich für Computer, konnten insbesondere in Asien weiter ausgebaut werden. Mit der Übernahme von SensoNor im Juni 2003 ergänzte das Unternehmen sein Produktportfolio der Kfz-Sensoren. Nach Angaben von Strategy Analytics steigerte der Geschäftsbereich seinen Marktanteil als Nummer eins in Europa auf über 15 Prozent; weltweit liegt Infineon mit 8 Prozent Marktanteil auf Rang zwei.

Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 6 Prozent auf 119 Millionen Euro, vor allem durch höhere Umsätze bei Access- und Fiber-Optic-Produkten. Das EBIT lag wegen der Wertminderung von 68 Millionen Euro

durch die Übernahme von Catamaran Communications bei minus 99 Millionen Euro, gegenüber minus 39 Millionen Euro im Vorquartal. Gestärkt wurde die ADSL-Marktposition mit einer Reihe von Design-Wins der Geminax-Chip-Technologie. Daneben ermöglicht der neue Triport-BIDI-Transceiver, der bereits an Großkunden geliefert wird, analoges TV, Telefonie und Internet-Zugang über eine einzige Fiber-Optic-Verbindung.

Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorquartal um drei Prozent auf 387 Millionen Euro, vor allem durch Sicherheitslösungen und Local Area Wireless-Applikationen, insbesondere Bluetooth. Vor allem das höhere Umsatzvolumen, insbesondere für Sicherheits-Controller, führte zu einem verbesserten Quartals-EBIT von minus 17 Millionen Euro, gegenüber minus 23 Millionen Euro im Vorquartal. Mit dem deutschen Innenministerium hat Infineon eine Kooperation vereinbart, um eine Technologiebasis für die verbesserte

Sicherheit von IT-Systemen im öffentlichen Dienst, in Privatunternehmen und Privathaushalten zu entwickeln. Vorgestellt hat das Unternehmen mit SingleStone ein Hochleistungsmodul für modernste Bluetooth-Applikationen.

Im Juni 2003 unterzeichneten Infineon und Ericsson einen Nachtrag zum Übernahmevertrag für das Ericsson Microelectronics-Geschäft, um ihre strategische Kooperation in der Mobiltelefon- und Mobilfunk-Infrastrukturtechnologie zu intensivieren. Sie einigten sich auf einen reduzierten Preis sowie die Aufhebung von Abnahmeverpflichtungen von Ericsson.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Speicherprodukte ist im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorquartal, hauptsächlich durch das ungünstige Euro/Dollar-Wechselkursverhältnis um sieben Prozent auf 569 Millionen Euro zurückgegangen. Daneben sind die Speicherpreise im Durchschnitt leicht gefallen. Hinzu kommen geringere Lizenzeinnahmen von 36 Millionen Euro. Das EBIT stieg deutlich auf 2 Millionen Euro gegenüber minus 138 Millionen Euro im Vorquartal, vor allem durch schneller als erwartete Produktivitätssteigerungen aus der 300-mm-Fertigung und durch keine wesentlichen Effekte aus Wertberichtigungen auf Lagerbestände.

Das Produkt mit dem größten Absatzvolumen, der 256-Mbyte-DDR-DRAM, ist von Intel in der 0,11-µm-Technologie validiert. Zudem reagierten die Kunden außerordentlich positiv auf die 1-Gbit-DDR-Synchronous-DRAM (SDRAM), die mit dem unternehmenseigenen 0,11-µm-CMOS-Verfahren hergestellt werden. Infineon hat mit IBM die Magnetoresistive Random Access Technology (MRAM) entwickelt und einen Hochgeschwindigkeits-128-Kbit-MRAM-Kern vorgestellt, der noch schnelleren Zugang, mehr Speicherplatz und weniger Stromverbrauch bei PCs und Laptops ermöglicht. Zusammen mit Cypress und Micron Technologies hat Infineon zudem die ersten Cellular-RAM-Muster für künftige Mobilfunkapplikationen angekündigt. Die ausführliche Quartalspressemeldung sowie den Quartalsbericht finden Sie im Internet unter www.infineon.com/boerse

AUSBLICK BIS ZUM ENDE DES KALENDERJAHRES 2003

Es zeichnet sich eine erste positive Marktentwicklung ab, die auf eine weiter verbesserte Nachfrage sowohl nach Logik-Bauelementen als auch nach Speicherprodukten hoffen lässt. Allerdings ist die globale Wirtschaftsentwicklung weiterhin ungewiss. Infineon setzt deshalb darauf, seine erfolgreichen Kostensenkungs- und Restrukturierungsprogramme fortzusetzen.

Im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen erwartet Infineon einen fortgesetzten Nachfrageanstieg für GSM/GPRS-Mobilfunkgeräte und Bluetooth-Produkte, zudem für Sicherheitslösungen, insbesondere für ID-Systeme, allerdings bei voraussichtlich anhaltendem Preisdruck.

Für die drahtgebundene Telekommunikations-Infrastruktur erwartet Infineon

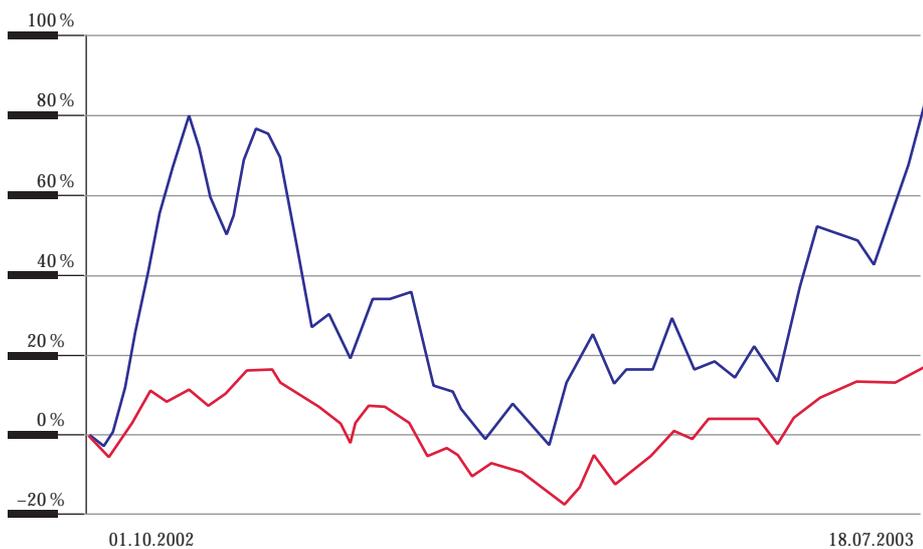
weltweite Investitionsrückgänge, wobei im europäischen Markt weiterhin ein leichtes Wachstum voraussehbar ist. Infineon rechnet mit einer steigenden Nachfrage nach Breitband-Zugangstechnologie, insbesondere in Asien.

In den Bereichen Automobilelektronik und Kfz-Halbleiter geht Infineon von einer saisonal schwächeren Nachfrage aus, wobei der Automobilelektronikmarkt trotz der aktuellen Schwäche der Automobilindustrie weiter wächst.

Für das gesamte Logik-Segment rechnet Infineon mit Verbesserungen bei Umsatz und EBIT im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2003.

Seit Anfang Juni 2003 verzeichnet Infineon ein Nachfrageplus und steigende Preise für DDR-Speicherprodukte. Infineon erwartet, dass die positive Nachfrageentwicklung anhält, getrieben vor allem durch die einsetzenden Erneuerungszyklen in Unternehmen, durch den anstehenden Beginn des neuen Schuljahres sowie steigende Megabyte-Kapazitäten pro Gerät und den wachsenden DRAM-Bedarf aufgrund der Einführung des neuen Intel Springdale-Chipsets, der Dual Channel DDR-Technologie für Computer bietet.

Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des Geschäftsjahres 02/03 (auf Basis der Wochen-Schlusskurse, geglättet)



INFINEON TECHNOLOGIES (XETRA)			DAX (XETRA)		
HOCH	06.11.02	12,08 EURO	HOCH	02.12.02	3.476,83
TIEF	09.10.02	5,03 EURO	TIEF	12.03.03	2.188,75
SCHLUSS	18.07.03	11,11 EURO	SCHLUSS	18.07.03	3.366,71

Hinweis:

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

INFINEON KALENDER

■ 10.11.03 Jahrespressekonferenz 2003, Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2003 inkl. des 4. Quartals (bis 30. September 2003)

■ 19.01.04 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal (bis 31. Dez.) des Geschäftsjahres 2004

■ 20.01.04 Hauptversammlung/ München

Messen und Ausstellungen

■ 08.11.03 Münchner Börsentag 2003/ München

IMPRESSUM

INVESTOR NEWSLETTER 6/2003

Herausgeber

Infineon Technologies AG

Investor Relations und

Finanzkommunikation

Postfach 80 09 49

81609 München

Tel.: +49 89 234-26655

Fax: +49 89 234-952987

E-Mail: investor.relations@infineon.com

www.infineon.com/boerse

Redaktion

Investor Relations